



H2159 环氧导电银胶

H2159 是一款单组分，热固化的导电粘接胶。本产品专为微电子芯片粘接应用而设计。H2159 具有稳定的触变性，适用于高速点胶工艺及手工探针应用。

产品描述

产品特性

条目	描述
技术类型	环氧
外观	银色膏体
组分	单组分
固化方式	热固化
应用	导电粘接
典型的产品应用	芯片贴装导电粘接

产品优点

- 稳定的触变性
- 低挥发分
- 优异的导电性、可靠性

产品性能

未固化时性能

条目	典型值	备注
粘度 cps	40,000±3000	ASTM D4287, 剪切速率5 S ⁻¹
触变指数 TI	6.0±0.2	ASTM D4287 0.5/5 S ⁻¹
室温有效期	24 小时	@ 25°C

固化后性能

条目	典型值	备注
----	-----	----



物理性能	热膨胀系数 ppm/°C	Tg 以下	55	TM A, 升温速度10°C/min
		Tg 以上	150	
	玻璃化转变温度(Tg) °C		110	TM A
	拉伸剪切强度 N/mm ²	铝/铝	11	GB/T 7124
	可萃取离子含量 ppm	Cl ⁻	≤20	
		Na ⁺	≤20	
		K ⁺	≤10	
	挥发份%		<0.35%	@300°C
电气性能	体积电阻率 Ω.cm		3*10 ⁻⁴	ASTM D257

典型的固化特性

推荐固化条件: 150°C/60min; 可替代固化温度 180°C/30min。固化条件（时间和温度）因固化设备、烤箱负载、实际烤箱温度而异，应依据客户经验、应用要求而调整。

使用前的注意事项：

- 使用前产品必须达到室温。
- 从冰箱取出后，25±2°C环境下需放置解冻半小时以上。
- 请勿在银胶温度达到 25°C 之前打开容器；打开容器之前，应清除解冻容器上积聚的任何水分。
- 不要重新冷冻；一旦解冻，产品不应再冷冻。

使用方法：

- 解冻后的产品应立即放在点胶设备上使用。
- 如果将产品转移到最终分配容器中，必须小心避免污染物和/或空气进入产品。
- 必须在产品推荐的使用寿命内用完。
- 如果产品在室温下 超过推荐的工作寿命后放置，可能会发生树脂与填料分离。

标准包装

- 10g / 支
- 按客户需求包装

产品储存



将产品存贮于未开封的原装容器内，并存放在干净、干燥的区域。存储信息同时标注于产品外包装标签。

本产品最佳存储条件：-40±2℃，存储期 9 个月。

为防止未使用产品受到污染，请不要将任何材料放回原装容器。本公司不对在前述情况以外的条件下被污染或储存的产品承担责任。更具体的保存期限信息，请咨询 Hanlicon 应用工程师。

注：本文中所含的各种数据仅供参考。对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果，我们恕不负责。自行决定把本产品用在本文中提及的产品应用外，及未采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的损失和人身伤害都是用户自己的责任。本公司明确声明对所有因销售公司产品或特定场合下使用本公司产品而出现的问题，包括针对某一特殊用途的适用性问题，我们不承担责任。公司明确声明对任何必然的或意外损失都不承担责任。建议用户每次在正式使用前都要根据本文提供的数据先做实验。

湖南创瑾科技有限公司

中国湖南省长沙市宁乡经济技术开发区谐园北路

中国长沙智能终端产业园 5 号栋

Tel: +86-731-87827556

www.trumjin.com